

天津金海通半导体设备股份有限公司

关于变更公司注册资本、修订公司章程 并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月10日召开第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于2025年度利润分配方案并修订<公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下：

一、关于变更注册资本的情况

公司拟以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4.50股。截至2026年3月10日，公司总股本为60,000,000股，本次以资本公积转增股本后，公司的总股本为87,000,000股。上述转增方案将于公司2025年年度股东会审议通过后实施。上述转增方案实施完毕后，公司总股本将由60,000,000股变更为87,000,000股，公司注册资本将由人民币60,000,000元变更为87,000,000元。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2026-023）。

二、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况

由于公司总股本及注册资本发生变更，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行如下修订：

修订前编号	修订前内容	修订后编号	修订后内容
第五条	公司注册资本为人民币 6,000 万元。	第五条	公司注册资本为人民币 8,700 万元。
第二十条	公司股份总数为	第二十条	公司股份总数为

	6,000 万股 ，全部为普通股。		8,700 万股 ，全部为普通股。
--	--------------------------	--	--------------------------

除上述条款修订外，其余条款内容不变。修订后的《公司章程》全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。公司董事会同时提请股东会授权公司董事会及董事会授权人士办理上述章程备案等相关事宜，授权有效期限自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 11 日